

双组份导热灌封胶

GF300是一款低粘度高效导热有机硅双组份灌封胶，导热系数 $3.0\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，分为A、B组分，按照1:1混合，混合均匀后能自排泡和常温固化，固化后具有防尘、防水防震、阻燃、密封、粘接、导热功能和优异的填缝效果，可用于发热电子元件的导热封装。



特性和优点

- 导热系数 $3.0\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- 操作时间可调
- 高电气绝缘
- 流动性、浸润性好
- 可实现自动化作业

典型应用

- OBC, DC-DC, 连接器, 传感器, 放大器等
- LED, 电源, 功率转换器, 变压器, 高压电阻器

***操作时间：**混合后，在操作时间内使用完毕

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色(A/B)	白色/蓝色	目视
粘度(mPa·s)	part A: 9250±1250	ASTM D2196, DV2T 粘度计 @6号转子, 转速50rpm
	part B: 9250±1250	
操作时间(h) @25℃	1~2	A/B按1:1混合后粘度上升到初始值两 倍的时间 @6号转子, 转速25rpm
固化时间(h) @25℃	<12	
固化时间(h) @70℃	0.5~1.0	
固化后		
密度(g/cc)	3.0±0.1	ASTM D792
硬度(Shore OO)	60±10	ASTM D2240
拉伸强度(MPa)	≥0.1	ASTM D412
断裂伸长率(%)	≥40	ASTM D412
耐温范围(℃)	-40~200	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	3	温度<40℃密封储存、避免暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	≥8.0	ASTM D149
介电常数	4.5~6.5	ASTM D150 @1MHz
体积电阻率(Ω·cm)	≥10 ¹²	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	3.0±0.3	ISO 22007-2
热膨胀系数(ppm/℃) @-40~150℃	≤90 (Z轴)	ASTM E831-2014